



JASDAQ

平成 28 年 6 月 22 日

各 位

会 社 名 日 特 エ ン ジ ニ ア リ ン グ 株 式 有 限 公 司
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 近 藤 進 茂
(コード番号 6 1 4 5)

問 い 合 っ せ 先
役 職 ・ 氏 名 執 行 役 員 管 理 本 部 長 磯 田 博
電 話 0 4 8 - 8 3 7 - 2 0 1 1

新製品の販売開始に関するお知らせ

当社は、株式会社リード（本社・横浜市 代表取締役・鍋谷陽介氏）より受注し、当社のワインディング技術を応用したダイヤモンドワイヤの製造装置について開発を行い、納入してまいりました。その後も開発を進め、同装置につきましては、芯線径40ミクロン以下のワイヤの製造を可能にすることができました。60ミクロンのワイヤは量産開始済みで、50、40ミクロンはサンプル供給がスタートしております。

その一方で、ダイヤモンドワイヤを使用し電子部品及び素材を切断する装置について、株式会社リードとオープンイノベーションを進め、今般、小型ダイシングワイヤソーの製造、販売を開始することになりましたので、お知らせいたします。

ダイヤモンドワイヤは、主としてピアノ線にダイヤモンド砥粒を固着させたワイヤで、これをリールに巻き取ります。ダイシングワイヤソーは、そのリールをセットして、高速でもう一方のリールに巻き取っていくという機構で、その高速で送られているダイヤモンドワイヤに素材を当てることによりその素材を切断する装置です。当社は、コアテクノロジーの一つである巻き取りの制御により、高速で安定した切断を達成し、また例えば、切断しながら複合材に含まれる材料の硬度によりリアルタイム制御し、最速2,000m/minで材料に適合した切断速度にするといった技術を開発いたしました。

ワイヤソーによるスライス加工は、これまでの主な需要が、太陽光発電用シリコンウェハの切断で、その芯線径は細いと言われるものでも60～80ミクロンでした。ダイヤモンドワイヤの芯線径が40ミクロンまで細くできることにより、微細な電子部品の素材、金属材料の切断などの需要にも応えることが可能になり、この度開発した小型ダイシングワイヤソーはその他にも需要が広がることが見込まれます。



本件開示が、業績予想に影響を与える影響については精査中であり、開示が必要と判断した場合には、速やかにその手続きを行います。

以 上